

目次

1. パッケージビジネスの現状と展望

1-1 パッケージビジネスの現状と展望	2
1-1-1 世界半導体産業の売上推移と展望	3
1-1-2 世界半導体後工程市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 "	3
1-1-3 世界パッケージ市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 "	4
1-1-4 世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望	4
1-1-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別売上一覧	5
1-1-6 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別社数構成比	6
1-1-7 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別売上構成比 (2023 年度)	6
1-2 後工程製造拠点および設備投資状況	7
1-2-1 後工程工場世界分布 (日本を除く)	8
1-2-2 世界 OSAT 上位 20 社の後工程工場世界分布 (日本を除く) "	8
1-2-3 世界半導体設備投資の推移と展望	9
1-2-4 世界半導体後工程設備投資の推移と展望	9
1-2-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別後工程設備投資一覧	10
1-2-6 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別設備投資構成比 (2023 年度)	10

2. 国内半導体企業のパッケージ事業戦略

2-1 ソニー株式会社	12
1) 事業戦略	12
2) 設備投資	13
3) 開発と今後の方向性	14
4) 半導体売上状況	15
5) 設備投資状況	15
6) 工場別提供パッケージ	16
7) 各工場のライン別一覧	17
2-2 東芝デバイス & ストレージ株式会社・キオクシア株式会社	21
1) 事業戦略	21
2) 設備投資	22
3) 開発と今後の方向性	23
4) 半導体売上状況	24
5) 設備投資状況	24
6) 工場別提供パッケージ	25
7) 各工場のライン別一覧	26
2-3 ルネサスエレクトロニクス株式会社	32
1) 事業戦略	32
2) 設備投資	33
3) 開発と今後の方向性	33
4) 半導体売上状況	34
5) 設備投資状況	34
6) 工場別提供パッケージ	35
7) 各工場のライン別一覧	36
2-4 富士電機株式会社	44
1) 事業戦略	44
2) 設備投資	44
3) 開発と今後の方向性	45
4) 半導体売上状況	46
5) 設備投資状況	46
6) 工場別提供パッケージ	47
7) 各工場のライン別一覧	48
2-5 サンケン電気株式会社	55
1) 事業戦略	55
2) 設備投資	56

3) 開発と今後の方向性	56
4) 半導体売上状況	58
5) 設備投資状況	58
6) 工場別提供パッケージ	59
7) 各工場のライン別一覧	60
2-6 ローム株式会社	66
1) 事業戦略	66
2) 設備投資	67
3) 開発と今後の方向性	67
4) 半導体売上状況 - (1) 全社製品別	69
4) 半導体売上状況 - (2) 後工程関連	69
5) 設備投資状況 - (1) 全社製品別	70
5) 設備投資状況 - (2) 後工程関連	70
6) 工場別提供パッケージ	71
7) 各工場のライン別一覧	72
2-7 三菱電機株式会社	83
1) 事業戦略	83
2) 設備投資	84
3) 開発と今後の方向性	84
4) 半導体売上状況	86
5) 設備投資状況	86
6) 工場別提供パッケージ	87
7) 各工場のライン別一覧	88
2-8 浜松ホトニクス株式会社	96
1) 事業戦略	96
2) 設備投資	96
3) 開発と今後の方向性	97
4) 半導体売上状況	98
5) 設備投資状況	98
6) 工場別提供パッケージ	99
7) 各工場のライン別一覧	100
2-9 ミネベアミツミ株式会社	105
1) 事業戦略	105
2) 設備投資	106
3) 開発と今後の方向性	107
4) 半導体売上状況	108
5) 設備投資状況	108
6) 工場別提供パッケージ	109
7) 各工場のライン別一覧	110
2-10 新電元工業株式会社	115
1) 事業戦略	115
2) 設備投資	115
3) 開発と今後の方向性	115
4) 半導体売上状況	117
5) 設備投資状況	117
6) 工場別提供パッケージ	118
7) 各工場のライン別一覧	119
2-11 シャープ株式会社	123
1) 事業戦略	123
2) 設備投資	124
3) 開発と今後の方向性	124
4) 半導体売上状況	125
5) 設備投資状況	125
6) 工場別提供パッケージ	126
7) 各工場のライン別一覧	127
2-12 コーデンシ株式会社	130
1) 事業戦略	130
2) 設備投資	131
3) 開発と今後の方向性	131
4) 半導体売上状況	132
5) 設備投資状況	132

Semiconductor Package Business Strategy 2025

6) 工場別提供パッケージ	133	3-2 Texas Instruments	192
7) 各工場のライン別一覧	134	1) 事業戦略	192
2-13 日清紡マイクロデバイス株式会社	137	2) 設備投資	193
1) 事業戦略	137	3) 開発と今後の方向性	193
2) 設備投資	138	4) 半導体売上状況	195
3) 開発と今後の方向性	138	5) 設備投資状況	195
4) 半導体売上状況	139	6) 工場別提供パッケージ	196
5) 設備投資状況	139	7) 各工場のライン別一覧	197
6) 工場別提供パッケージ	140	3-3 Micron Technology	203
7) 各工場のライン別一覧	141	1) 事業戦略	203
2-14 スタンレー電気株式会社	143	2) 設備投資	204
1) 事業戦略	143	3) 開発と今後の方向性	205
2) 設備投資	144	4) 半導体売上状況	206
3) 開発と今後の方向性	144	5) 設備投資状況	206
4) 半導体売上状況	145	6) 工場別提供パッケージ	207
5) 設備投資状況	145	7) 各工場のライン別一覧	208
6) 工場別提供パッケージ	146	3-4 ON Semiconductor	214
7) 各工場のライン別一覧	147	1) 事業戦略	214
2-15 京セラ株式会社	151	2) 設備投資	215
1) 事業戦略	151	3) 開発と今後の方向性	216
2) 設備投資	151	4) 半導体売上状況	217
3) 開発と今後の方向性	152	5) 設備投資状況	217
4) 半導体売上状況	153	6) 工場別提供パッケージ	218
5) 設備投資状況	153	7) 各工場のライン別一覧	219
6) 工場別提供パッケージ	154	3-5 Analog Devices	231
7) 各工場のライン別一覧	155	1) 事業戦略	231
2-16 セイコーエプソン株式会社	158	2) 設備投資	232
1) 事業戦略	158	3) 開発と今後の方向性	232
2) 設備投資	158	4) 半導体売上状況	234
3) 開発と今後の方向性	158	5) 設備投資状況	234
4) 半導体売上状況	160	6) 工場別提供パッケージ	235
5) 設備投資状況	160	7) 各工場のライン別一覧	236
6) 工場別提供パッケージ	161	3-6 Samsung Electronics	239
7) 各工場のライン別一覧	162	1) 事業戦略	239
2-17 デクセリアルズ株式会社	165	2) 設備投資	240
1) 事業戦略	165	3) 開発と今後の方向性	241
2) 設備投資	166	4) 半導体売上状況	242
3) 開発と今後の方向性	166	5) 設備投資状況	242
4) 半導体売上状況	167	6) 工場別提供パッケージ	243
5) 設備投資状況	167	7) 各工場のライン別一覧	244
6) 工場別提供パッケージ	168	3-7 SK Hynix	247
7) 各工場のライン別一覧	169	1) 事業戦略	247
2-18 株式会社オリジン	171	2) 設備投資	248
1) 事業戦略	171	3) 開発と今後の方向性	249
2) 設備投資	172	4) 半導体売上状況	250
3) 開発と今後の方向性	172	5) 設備投資状況	250
4) 半導体売上状況	173	6) 工場別提供パッケージ	251
5) 設備投資状況	173	7) 各工場のライン別一覧	252
6) 工場別提供パッケージ	174	3-8 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation)	255
7) 各工場のライン別一覧	175	1) 事業戦略	255
		2) 設備投資	256
		3) 開発と今後の方向性	257
		4) 半導体売上状況	259
		5) 設備投資状況	259
		6) 工場別提供パッケージ	260
		7) 各工場のライン別一覧	261
		3-9 Infineon Technologies	266
		1) 事業戦略	266
		2) 設備投資	267
		3) 開発と今後の方向性	268

3. 海外半導体企業のパッケージ事業戦略

3-1 Intel Corporation	178
1) 事業戦略	178
2) 設備投資	180
3) 開発と今後の方向性	180
4) 半導体売上状況	183
5) 設備投資状況	183
6) 工場別提供パッケージ	184
7) 各工場のライン別一覧	185

4) 半導体売上状況	270	5) 設備投資状況	337
5) 設備投資状況	270	6) 工場別提供パッケージ	338
6) 工場別提供パッケージ	271	7) 各工場のライン別一覧	339
7) 各工場のライン別一覧	272	4-6 エスタカヤ電子工業株式会社	343
3-10 NXP Semiconductors	282	1) 事業戦略	343
1) 事業戦略	282	2) 設備投資	343
2) 設備投資	283	3) 開発と今後の方向性	343
3) 開発と今後の方向性	283	4) 半導体売上状況	344
4) 半導体売上状況	285	5) 設備投資状況	344
5) 設備投資状況	285	6) 工場別提供パッケージ	345
6) 工場別提供パッケージ	286	7) 各工場のライン別一覧	346
7) 各工場のライン別一覧	287	4-7 株式会社ミスズ工業	347
3-11 STMicroelectronics	291	1) 事業戦略	347
1) 事業戦略	291	2) 設備投資	347
2) 設備投資	292	3) 開発と今後の方向性	347
3) 開発と今後の方向性	293	4) 半導体売上状況	348
4) 半導体売上状況	294	5) 設備投資状況	348
5) 設備投資状況	294	6) 工場別提供パッケージ	349
6) 工場別提供パッケージ	295	7) 各工場のライン別一覧	350
7) 各工場のライン別一覧	296	4-8 東洋電子工業株式会社	352
		1) 事業戦略	352
		2) 設備投資	352
		3) 開発と今後の方向性	352
		4) 半導体売上状況	353
		5) 設備投資状況	353
		6) 工場別提供パッケージ	354
		7) 各工場のライン別一覧	355
4. 国内 OSAT 企業のパッケージ事業戦略		4-9 大津電子株式会社	358
4-1 アオイ電子株式会社	306	1) 事業戦略	358
1) 事業戦略	306	2) 設備投資	358
2) 設備投資	307	3) 開発と今後の方向性	358
3) 開発と今後の方向性	307	4) 半導体売上状況	359
4) 半導体売上状況	308	5) 設備投資状況	359
5) 設備投資状況	308	6) 工場別提供パッケージ	360
6) 工場別提供パッケージ	309	7) 各工場のライン別一覧	361
7) 各工場のライン別一覧	310	4-8 株式会社野田市電子	362
4-2 新光電気工業株式会社	315	1) 事業戦略	362
1) 事業戦略	315	2) 設備投資	362
2) 設備投資	316	3) 開発と今後の方向性	362
3) 開発と今後の方向性	316	4) 半導体売上状況	363
4) 半導体売上状況	317	5) 設備投資状況	363
5) 設備投資状況	317	6) 工場別提供パッケージ	364
6) 工場別提供パッケージ	318	7) 各工場のライン別一覧	365
7) 各工場のライン別一覧	319		
4-3 株式会社加藤電器製作所	320	5. 海外 OSAT 企業のパッケージ事業戦略	
1) 事業戦略	320	5-1 ASE (Advanced Semiconductor Engineering)	368
2) 設備投資	321	1) 事業戦略	368
3) 開発と今後の方向性	321	2) 設備投資	369
4) 半導体売上状況	322	3) 開発と今後の方向性	369
5) 設備投資状況	322	4) 半導体売上状況	371
6) 工場別提供パッケージ	323	5) 設備投資状況	371
7) 各工場のライン別一覧	324	6) 工場別提供パッケージ	372
4-4 内藤電誠グループ	328	7) 各工場のライン別一覧	373
1) 事業戦略	328	5-2 Amkor Technology	392
2) 設備投資	329	1) 事業戦略	392
3) 開発と今後の方向性	329	2) 設備投資	393
4) 半導体売上状況	330	3) 開発と今後の方向性	394
5) 設備投資状況	330	4) 半導体売上状況	396
6) 工場別提供パッケージ	331	5) 設備投資状況	396
7) 各工場のライン別一覧	332		
4-5 エムテックスマツムラ株式会社	335		
1) 事業戦略	335		
2) 設備投資	335		
3) 開発と今後の方向性	336		
4) 半導体売上状況	337		

Semiconductor Package Business Strategy 2025

6) 工場別提供パッケージ	397	3) 開発と今後の方向性	516
7) 各工場のライン別一覧	398	4) 半導体売上状況	517
5-3 JCET Group	418	5) 設備投資状況	517
1) 事業戦略	418	6) 工場別提供パッケージ	518
2) 設備投資	419	7) 各工場のライン別一覧	519
3) 開発と今後の方向性	420	5-11 OSE (Orient Semiconductor Electronics)	524
4) 半導体売上状況	422	1) 事業戦略	524
5) 設備投資状況	422	2) 設備投資	525
6) 工場別提供パッケージ	423	3) 開発と今後の方向性	525
7) 各工場のライン別一覧	424	4) 半導体売上状況	526
5-4 Tongfu Microelectronics (通富微電子)	430	5) 設備投資状況	526
1) 事業戦略	430	6) 工場別提供パッケージ	527
2) 設備投資	431	7) 各工場のライン別一覧	528
3) 開発と今後の方向性	432	5-12 SFA Semicon	529
4) 半導体売上状況	433	1) 事業戦略	529
5) 設備投資状況	433	2) 設備投資	530
6) 工場別提供パッケージ	434	3) 開発と今後の方向性	530
7) 各工場のライン別一覧	435	4) 半導体売上状況	532
5-5 Powertech Technology	445	5) 設備投資状況	532
1) 事業戦略	445	6) 工場別提供パッケージ	533
2) 設備投資	446	7) 各工場のライン別一覧	534
3) 開発と今後の方向性	447	5-13 Nepes	537
4) 半導体売上状況	449	1) 事業戦略	537
5) 設備投資状況	449	2) 設備投資	538
6) 工場別提供パッケージ	450	3) 開発と今後の方向性	539
7) 各工場のライン別一覧	451	4) 半導体売上状況	540
5-6 UTAC	462	5) 設備投資状況	540
1) 事業戦略	462	6) 工場別提供パッケージ	541
2) 設備投資	463	7) 各工場のライン別一覧	542
3) 開発と今後の方向性	464	5-14 Carsem	548
4) 半導体売上状況	466	1) 事業戦略	548
5) 設備投資状況	466	2) 設備投資	549
6) 工場別提供パッケージ	467	3) 開発と今後の方向性	549
7) 各工場のライン別一覧	468	4) 半導体売上状況	550
5-7 Tianshui Huatian Technology (TSHT)	477	5) 設備投資状況	550
1) 事業戦略	477	6) 工場別提供パッケージ	551
2) 設備投資	478	7) 各工場のライン別一覧	552
3) 開発と今後の方向性	479	5-15 Formosa Advanced Technologies (FATC)	555
4) 半導体売上状況	480	1) 事業戦略	555
5) 設備投資状況	480	2) 設備投資	556
6) 工場別提供パッケージ	481	3) 開発と今後の方向性	556
7) 各工場のライン別一覧	482	4) 半導体売上状況	557
5-8 ChipMOS Technologies	493	5) 設備投資状況	557
1) 事業戦略	493	6) 工場別提供パッケージ	558
2) 設備投資	494	7) 各工場のライン別一覧	559
3) 開発と今後の方向性	494	5-16 Walton Advanced Engineering	560
4) 半導体売上状況	496	1) 事業戦略	560
5) 設備投資状況	496	2) 設備投資	561
6) 工場別提供パッケージ	497	3) 開発と今後の方向性	561
7) 各工場のライン別一覧	498	4) 半導体売上状況	562
5-9 Chipbond Technology	502	5) 設備投資状況	562
1) 事業戦略	502	6) 工場別提供パッケージ	563
2) 設備投資	503	7) 各工場のライン別一覧	564
3) 開発と今後の方向性	504	5-17 Signetics	570
4) 半導体売上状況	505	1) 事業戦略	570
5) 設備投資状況	505	2) 設備投資	570
6) 工場別提供パッケージ	506	3) 開発と今後の方向性	571
7) 各工場のライン別一覧	507	4) 半導体売上状況	572
5-10 HANA Micron	514	5) 設備投資状況	572
1) 事業戦略	514	6) 工場別提供パッケージ	573
2) 設備投資	515	7) 各工場のライン別一覧	574

5-18 Suzhou Good-Ark Electronics	575
1) 事業戦略	575
2) 設備投資	575
3) 開発と今後の方向性	576
4) 半導体売上状況	577
5) 設備投資状況	577
6) 工場別提供パッケージ	578
7) 各工場のライン別一覧	579
5-19 China Wafer Level CSP	582
1) 事業戦略	582
2) 設備投資	583
3) 開発と今後の方向性	583
4) 半導体売上状況	584
5) 設備投資状況	584
6) 工場別提供パッケージ	585
7) 各工場のライン別一覧	586